证券代码：688082　证券简称：盛美上海　公告编号：2023-011

盛美半导体设备(上海)股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利3.72元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 公司2022年年度拟分配的现金红利总额与2022年年度归属于上市公司股东净利润之比低于30%，主要是出于对目前公司所处的行业特点及发展阶段，结合目前经营状况及未来资金需求的综合考虑。为推动公司各项战略规划落地，保证公司持续、稳定、健康发展，公司提出此2022年度利润分配方案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定发展的需求。

一、利润分配方案的内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2023]第ZI10026号），2022年母公司实现税后净利润645,491,702.25元，提取10%的法定盈余公积金64,549,170.23元，加上年初母公司未分配利润477,072,770.33元。截至2022年12月31日，母公司实现可供分配利润额为人民币1,058,015,302.35元。经第二届董事会第三次会议决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：

截至2022年12月31日，公司总股本为433,557,100股，以总股本为基准，拟每10股派发现金红利3.72元（含税），共计派发现金红利161,283,241.20元（含税），本次利润分配现金分红金额占2022年合并报表归属于母公司股东净利润的24.13%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润668,486,949.72元，截至2022年12月31日，母公司累计未分配利润为1,058,015,302.35元，公司拟分配的现金红利总额为161,283,241.20（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处的半导体专用设备行业属于技术密集型行业，涉及微电子、电气、机械、材料、化学工程、流体力学、自动化、图像识别、通讯、软件系统等众多学科领域，具有较高的技术研发门槛。全球半导体专用设备行业市场竞争激烈，国际头部企业每年都将大量资金投入研发以保证产品的技术提升及在市场中的竞争力，公司产品在其面向的市场均与国际头部企业直接竞争。在此情况下，公司需要投入大量资金用于推动技术创新和产品升级，以不断提升公司技术实力与核心竞争力。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司目前正处于快速成长及战略布局的重要发展阶段，经营规模不断增大。公司将紧紧围绕整体发展战略，以技术创新为核心发展动力，以市场为导向，不断提高经营管理水平，持续在技术突破、新产品研制开发、人才培养、市场开拓、兼并收购、内控建设等多方面保持较大投入，加强公司领先优势，加快战略项目拓展，巩固并提升市场占有率，在保持合理的毛利率的同时，扩大公司的收入规模，为客户及股东创造价值。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

公司2022年度实现营业收入2,873,045,516.26元，同比增长77.25%，实现归属于上市公司股东的净利润668,486,949.72元，同比增长151.08%。公司盈利能力不断增强，整体财务状况向好。但因处于快速发展阶段仍有较大的资金需求。在充分考虑了目前的行业发展状况，公司发展战略以及重大资金支出安排等因素后，公司决定留存足额资金来满足研发投入、产能建设、业务发展及流动资金需求，充分保障公司平稳运营、健康发展。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段，结合目前经营状况及未来资金需求，为推动公司各项战略规划落地，保证公司持续、稳定、健康发展，公司提出此2022年度利润分配方案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定发展的需求。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将转入下一年度，用于加大研发投入、加强生产经营发展，以提升公司核心竞争力，提高产品竞争力，进一步提升公司行业地位。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年2月23日，公司召开第二届董事会第三次会议，全票审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议，经批准后实施。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2022年度利润分配预案，是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。其决策程序合法，符合有关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司2022年度利润分配预案，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

三、相关风险提示

公司本次利润分配预案结合了公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司
董事会
2023年2月25日

证券代码：688082　证券简称：盛美上海　公告编号：2023-013

盛美半导体设备(上海)股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2023年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘的会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户398家。

2.投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4,500万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	唐艺	2013年	2014年	2012年	2019年
签字注册会计师	张静	2020年	2016年	2020年	2021年
质量控制复核人	章顺文	1994年	2008年	2008年	2022年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：唐艺

时间	上市公司名称	职务
2022年	盛美半导体设备（上海）股份有限公司	签字合伙人
2021年	深圳可立克科技股份有限公司	签字合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张静

时间	上市公司名称	职务
2022年	盛美半导体设备（上海）股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：章顺文

时间	上市公司名称	职务
2022年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字合伙人
2022年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	深南电路股份有限公司	签字合伙人
2022年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	签字合伙人
2022年	广东海川智能机器股份有限公司	签字合伙人
2022年	深圳市行健自动化股份有限公司	签字合伙人
2021年	深圳长城开发科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字合伙人
2021年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	惠州光弘科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	深圳市行健自动化股份有限公司	签字合伙人
2020年	深圳长城开发科技股份有限公司	签字合伙人
2020年	东风电子科技股份有限公司	签字合伙人
2020年	惠州光弘科技股份有限公司	签字合伙人

2.项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、审计收费

公司2022年度的审计费用为人民币290万元，其中财务报告审计费用250万元、内部控制审计费用40万元。2023年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了严格审核。审计委员会认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事相关业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作起到了积极的建设性作用。在其担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。因此，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交至公司董事会审议。

独立董事独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，所出具的公司财务审计报告客观、真实，准确反映了公司的财务状况、经营成果，工作勤勉尽责，执业水平良好。公司续聘2023年度审计机构的相关程序符合《中华人民共和国公司法》《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为。我们同意董事会审议通过相关议案后将其提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司董事会已于2023年2月23日召开的第二届董事会第三次会议，审议并全票通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次续聘2023年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司
董事会
2023年2月25日

证券代码：688082　证券简称：盛美上海　公告编号：2023-014

盛美半导体设备(上海)股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意盛美半导体设备（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2689号）批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）43,355,753股，发行价格为85.00元/股，募集资金总额为人民币3,685,239,005.00元，扣除承销商保荐及承销费用人民币173,832,028.54元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币30,148,456.12元（包括：审计费及验资费12,467,000.00元、律师费10,904,467.37元、用于本次发行的信息披露费用4,575,471.70元、发行手续费及材料制作费等2,201,517.05元），募集资金净额为人民币3,481,258,520.34元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZI10561号《验资报告》。

（二）2022年度募集资金使用情况及结余情况

截至2022年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：

项目	募集资金发生情况（人民币元）
2021年募集资金结余金额	2,830,374,553.82
减：本报告期募集资金使用金额	727,591,087.74
减：手续费	61,496.72
减：支付的发行费用	8,389,596.45
减：以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用置换额	217,839,663.21
加：利息收入	25,462,878.58
募集资金结余金额	1,901,955,588.28

注：募集资金结余金额详情见本专项报告二、（二）及三、（四）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。

2021年11月，公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海分行、中国光大银行股份有限公司上海昌里支行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、上海银行股份有限公司浦东分行、招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行、上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行、招商银行股份有限公司上海淮海支行、兴业银行股份有限公司上海市北支行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行、中国工商银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司盛帷半导体设备（上海）有限公司和保荐机构海通证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海分行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2022年10月，公司和保荐机构海通证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2022年12月31日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金存储情况

截至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：

开户银行名称	银行账号	金额（人民币元）	备注
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121909929210918	456,184,015.24	活期存款
中国光大银行股份有限公司上海昌里支行	36750180808738885	2,636,029.91	活期存款
	36750181000061340	100,000,000.00	定期存款
中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行	452082279585	31,604.15	活期存款
上海银行股份有限公司张江支行	03004750062	31,534.50	活期存款
招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行	121909929210858	130,105.22	活期存款
	12190992928200038	200,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	97080078801900002063	155,266,762.26	活期存款
招商银行股份有限公司上海淮海支行	121909929210202	21,928,652.48	活期存款
	12190992928200041	270,000,000.00	定期存款
兴业银行股份有限公司上海市北支行	216420100100156371	79,997,102.14	活期存款
	216420100200109025	100,000,000.00	定期存款
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000444066	617,603.00	活期存款
	70090122000466261	300,000,000.00	定期存款
中国工商银行股份有限公司上海市滴水湖支行	1001747729300001088	3,854,247.41	活期存款
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121938866210666	1,277,931.97	活期存款
合计		1,691,955,588.28	

注：定期账户为系统自动生成，依托于活期账户而存在，资金进出均需通过募集资金专户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司于2022年3月1日分别召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币209,203,489.29元置换预先投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币8,636,173.92元置换已预先支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金人民币217,839,663.21元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司监事会、独立董事对本事项发表了意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金投资项目先期投入及置换情况进行了专项核验，并出具了《盛美半导体设备（上海）股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZI10013号）。

具体内容详见公司于2022年3月2日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-009）。

截至2022年12月31日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年12月31日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于2022年8月18日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币20亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-023）。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

签约银行	产品名称	起息日	到期日	金额（元）	年化收益率
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	大额存单	2022.10.20	2025.10.20	10,000,000.00	3.10%
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	大额存单	2022.10.20	2025.10.20	10,000,000.00	3.10%
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	大额存单	2022.10.20	2025.10.20	10,000,000.00	3.10%
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	大额存单	2022.10.20	2025.10.20	10,000,000.00	3.10%
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	大额存单	2022.10.20	2025.10.20	10,000,000.00	3.10%
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	大额存单	2022.11.14	2025.11.14	10,000,000.00	3.10%
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	大额存单	2022.11.14	2025.11.14	10,000,000.00	3.10%
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	大额存单	2022.11.14	2025.11.14	10,000,000.00	3.10%
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	大额存单	2022.11.14	2025.11.14	10,000,000.00	3.10%
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	大额存单	2022.11.14	2025.11.14	10,000,000.00	3.10%
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	大额存单	2022.12.8	2025.12.8	10,000,000.00	3.10%
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	大额存单	2022.12.8	2025.12.8	10,000,000.00	3.10%
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	大额存单	2022.12.8	2025.12.8	10,000,000.00	3.10%
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	大额存单	2022.12.15	2025.12.15	10,000,000.00	3.10%
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	大额存单	2022.12.15	2025.12.15	10,000,000.00	3.10%
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	大额存单	2022.12.15	2025.12.15	10,000,000.00	3.10%
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	大额存单	2022.12.30	2025.12.30	10,000,000.00	3.10%
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	大额存单	2022.12.30	2025.12.30	10,000,000.00	3.10%
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	大额存单	2022.12.30	2025.12.30	10,000,000.00	3.10%
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	大额存单	2022.12.30	2025.12.30	10,000,000.00	3.10%
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	大额存单	2022.12.30	2025.12.30	10,000,000.00	3.10%

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022年12月31日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司于2022年8月4日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用74,773.07万元（含利息收益）用于投资建设新项目，其中使用超募资金人民币73,087.15万元。该议案于2022年9月8日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年8月8日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2022-019）

（七）节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2022年12月31日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定编制，如实反映了公司2022年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2022年12月31日，盛美上海不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对盛美上海2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司
董事会
2023年2月25日

附表：

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：盛美半导体设备（上海）股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额（注1）		3,481,258,520.34		本年度投入募集资金总额（注2）								936,794,577.03
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额								1,607,932,475.51
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)（注2）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
盛美半导体设备研发与制造中心	不适用	700,000,000.00	不适用	700,000,000.00	234,794,239.10	249,141,205.03	-450,858,794.97	35.59	2023年	不适用	不适用	否
盛美半导体高端半导体设备研发项目	不适用	450,000,000.00	不适用	450,000,000.00	316,608,524.13	349,321,493.11	-100,678,506.89	77.63	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	650,000,000.00	不适用	650,000,000.00	17,348,570.90	641,426,534.47	-8,573,465.53	98.68	不适用	不适用	不适用	否
高端半导体设备拓展研发项目	不适用	730,871,500.00	不适用	730,871,500.00	368,043,242.90	368,043,242.90	-362,828,257.10	50.36	不适用	不适用	不适用	否
合计		2,530,871,500.00		2,530,871,500.00	936,794,577.03	1,607,932,475.51	-922,939,024.49	63.53				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见专项报告三、（二）											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	见专项报告三、（四）											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	见专项报告三、（六）											

注1："募集资金总额"是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币3,481,258,520.34元。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

证券代码：688082　证券简称：盛美上海　公告编号：2023-015

盛美半导体设备(上海)股份有限公司关于使用部分超募资金向全资孙公司增资以实施新建项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 新项目名称：盛美韩国半导体设备研发与制造中心（以下简称"本项目"或"项目"）。

● 投资金额及资金来源：本项目计划总投资24,500.00万元，其中，建设投资18,984.70万元，研发投入5,515.30万元。资金来源为盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"盛美上海"）首次公开发行股票募集资金中超募资金。

● 公司于2023年2月23日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资孙公司增资以实施新建项目的议案》，同意公司以超募资金人民币24,500.00万元（折合韩元约462.95亿，暂以董事会审议日汇率测算，具体外币金额以增资当日汇率为准）向全资孙公司ACM Research Korea CO.，LTD.（以下简称"盛美韩国"）增资以新建并实施"盛美韩国半导体设备研发与制造中心"项目，并同意通过技术许可的方式，将现有成熟技术授权于盛美韩国，应用到本项目的研发生产中。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

● 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

● 相关风险提示：项目建设过程中，可能面临海外投资风险、市场风险以及产品研发风险。因此项目对公司未来业绩的影响具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意盛美半导体设备（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2689号），公司于2021年11月18日首次公开发行A股43,355,753股，每股的发行价格为人民币85.00元，募集资金总额为人民币3,685,239,005.00元，扣除发行费用人民币203,980,484.66元（不含增值税，下同）后，实际募集资金净额（以下简称"募资净额"）为人民币3,481,258,520.34元。上述募资净额已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZI10561号《验资报告》予以确认。

为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

二、募集资金使用情况

根据《盛美半导体设备（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司的募集资金投资项目及募集资金的使用计划具体如下：

单位：元

序号	募投项目	投资总额	拟使用募集资金金额
1	盛美半导体设备研发与制造中心	882,450,000.00	700,000,000.00
2	盛美半导体高端半导体设备研发项目	450,000,000.00	450,000,000.00
3	补充流动资金	650,000,000.00	650,000,000.00
合计		1,982,450,000.00	1,800,000,000.00

（一）募集资金先期投入及置换情况

公司于2022年3月1日分别召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为217,839,663.21元。公司监事会、独立董事对本事项发表了意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告。具体内容详见公司于2022年3月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-009）。

（二）公司超募资金情况

公司首次公开发行股票超募资金171,141.07万元，截至2022年12月31日，公司超募资金三方存管账户余额及其产生的利息合计97,652.77万元。

公司于2022年8月4日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用74,773.07万元（含利息收益）用于投资建设新项目，其中使用超募资金人民币73,087.15万元。该议案于2022年9月8日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年8月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2022-019）。

（三）闲置募集资金使用情况

公司于2022年8月18日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币20亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事对本事项发表了意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-023）。

三、本次使用部分超募资金向全资孙公司增资以实施新建项目的情况

（一）增资的基本情况

公司于2023年2月23日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资孙公司增资以实施新建项目的议案》，同意公司以超募资金人民币24,500.00万元（折合韩元约462.95亿，暂以董事会审议日汇率测算，具体外币金额以增资当日汇率为准）向全资孙公司盛美韩国增资以新建并实施本项目，并同意通过技术许可的方式，将现有成熟技术授权于盛美韩国，应用到本项目的研发生产中。

（二）本次增资对象的基本情况

项目	基本情况	
企业名称	ACM Research Korea Co., LTD.	
法人号码	134411-0078948	
注册地址	韩国京畿道利川市夫钵邑京忠大路2106，402号（现代City Plaza）	
代表理事	金永律（YOUNG YOUL KIM）	
注册资本（本次增资前）	1亿韩元	
已发行股份数	20,000股（非上市企业）	
成立日期	2017年12月5日	
主营业务	半导体专用设备的研发、生产和销售，为公司进行半导体专用设备和零部件的研发，同时为公司采购半导体专用设备的零部件。	
股东情况	公司全资子公司清芯科技有限公司持有100%股权	
主要财务数据（人民币万元）	项目	2022年12月31日/2022年度
	总资产	21,125.04
	负债总额	19,621.35
	净资产	1,503.69
	营业收入	29,732.57
	净利润	-20.93
	扣除非经常损益后的净利润	-20.93
	审计情况	2022年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三）本次增资目的及对公司的影响

公司本次使用超募资金对盛美韩国进行增资，是基于公司使用部分超募资金投资建设新项目的需要，有助于推进新项目的建设，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、本次使用部分超募资金建设新项目的具体情况

（一）项目概况

本项目将在韩国购置土地，建设新的办公大楼、洁净室及生产车间，建成盛美韩国半导体设备研发与制造中心，改善盛美韩国的研发生产条件，提升盛美韩国的研发实力及产业化能力，并将通过技术许可的方式，将现有成熟技术授权于盛美韩国，应用到本项目的研发生产中。通过本项目，公司将进一步完善全球化产业布局，贴近全球半导体先进制程企业，加快推进产品通过客户验证，增强公司客户服务能力，同时，也将引入更多半导体领域的先进技术人才，增强公司的人才储备。

（二）项目基本情况

1. 项目名称：盛美韩国半导体设备研发与制造中心
2. 项目实施主体：ACM Research Korea CO.，LTD.
3. 项目实施地点：韩国京畿道龙仁市处仁区阳智面雰日里63-2号
4. 项目投资构成：本项目计划总投资24,500.00万元，其中，建设投资18,984.70万元，研发投入5,515.30万元。资金来源为公司首次公开发行股票募集资金中超募资金。
5. 项目建设周期：本项目建设周期为2年，最终以实际开展情况为准。

（三）项目投资的必要性和可行性分析

1. 项目投资的必要性

（1）落地公司发展战略，完善全球产业布局

近年来，公司秉承技术差异化、产品平台化、客户全球化的理念，不断加快国内外市场布局，提高公司产品的市场份额，增强核心竞争力。随着半导体行业下游5G通信、计算机、消费电子、网络通信、汽车电子、物联网等行业的发展，芯片制造企业产能持续扩张，公司半导体专用设备面临的市场需求将进一步增长，公司亟需加快完善全球产业布局，实现半导体专用设备的产能扩张，提升公司在行业内的竞争力。

本项目将利用盛美上海现有客户基础及技术优势，在韩国建设研发及制造中心。本项目的实施，将进一步完善公司的全球化产业布局，加快公司跻身国际一流集成电路装备企业行列的步伐，是落地公司未来发展战略的重要举措。

（2）增强客户响应能力，加快推进产品验证及产业化

半导体行业客户对半导体专用设备的质量、技术参数、稳定性等有严苛的要求，对新设备供应商的选择也较为慎重。通常，半导体行业客户要求设备供应商先提供产品供其测试，待通过内部验证后纳入合格供应商名单；部分客户尚需将使用该设备生产的半导体产品送至其下游客户处，获得其客户认可后，才会纳入合格供应商名单。因此，半导体专用设备企业在客户验证、开拓市场方面周期较长、难度较大。韩国是仅次于中国大陆地区的全球第二大半导体设备市场。根据国际半导体产业协会SEMI发布的《全球半导体设备市场统计报告》，2021年韩国半导体设备销售额增长55%，达到250亿美元，占全球半导体设备销售额的24.34%。

本项目立足于全球第二大半导体设备市场，具有广阔的市场空间，项目的实施将缩短公司与客户的服务距离，极大地提升公司在韩国本土的客户响应能力，加快推进产品通过客户验证，降低市场开拓的难度。

（3）改善研发生产条件，增强专业人才储备

公司高度重视技术研发团队建设和培养，自设立以来，持续培养和引进全球行业内的专业人才，经过多年的积累，公司拥有了一支国际化、专业化的技术研发团队。目前，公司已在韩国组建了专业的研发团队，依靠韩国在机械电子领域的技术人才，与中国大陆的研发团队取长补短。

通过本项目的建设，公司将进一步改善在韩国的生产及研发条件，吸引更多的专业人才加入公司，增强公司的专业人才储备，增强生产能力及研发实力。此外，韩国作为全球主要的半导体市场，拥有一大批先进制程的半导体企业，通过相关专业技术人才的引进，有助于拓宽公司的国际化视野和思维，及时掌握半导体产业技术发展趋势，为公司未来的可持续发展打下坚实基础。

2. 项目投资的可行性

（1）本项目具有良好的市场前景

半导体专用设备市场与半导体产业景气状况紧密相关，随着下游消费电子需求回暖，叠加汽车电子产业快速扩张，全球半导体产业景气度高涨带动半导体设备市场规模持续扩张。根据国际半导体产业协会SEMI相关统计，作为全球主要的半导体设备销售地之一，韩国半导体设备市场受益全球半导体产业景气度的回升，在2020年实现强劲增长后，2021年继续实现快速增长，较2020年的销售额增长55%，达到249.80亿美元，是仅次于中国的第二大半导体设备市场。未来，随着全球半导体行业的进一步发展，以及韩国政府对半导体产业的重视与推动，韩国半导体设备行业仍将在全球半导体设备市场中继续发展并占据重要地位。

综上所述，本项目产品具有良好的市场前景，具备产业化的市场基础。

（2）公司具备项目实施的技术储备

公司高度重视科技创新，从2007年以来，长期坚持自主研发，以差异化立足，顺应技术发展趋势，通过持续的研发投入和长期的技术、工艺积累，在新产品开发、生产工艺改进等方面形成了一系列科技成果，对公司持续提升产品品质、丰富产品布局起到了关键性的作用。截至2022年12月31日，公司及控股子公司拥有已获授予专利权的主要专利389项，其中，发明专利384项，实用新型专利3项，外观设计专利2项。在核心技术方面，公司目前已掌握了半导体清洗设备、半导体电镀设备、先进封装设备等各类产品领域的多项核心技术，部分已达到国际领先水平，并已成熟地应用于产品的批量化生产中。针对以上知识产权及核心技术，公司将通过技术许可的方式，将现有成熟技术授权于盛美韩国，应用到本项目的研发生产中。

综上所述，本项目具备实施的技术基础，为项目的实施提供技术保障。

（3）公司拥有较强的市场开拓能力

公司自设立以来，始终采取差异化的市场开拓策略，首先开拓全球半导体龙头企业客户，通过长时间的研发和技术积累，取得其对公司技术和产品的认可，以树立公司的市场声誉，然后凭借在国际行业取得的业绩和声誉，持续开拓其他半导体行业新兴区域市场。在具体销售模式方面，目前公司形成了代理销售和自主销售相结合的双轮驱动销售模式。在公司发展的前期，为覆盖更多潜在客户，公司主要通过代理商开拓市场，与代理商建立了长期稳定的合作关系；随着公司业务规模的不断扩大，公司也开始着手培育和扩大自身销售队伍，提高自主销售能力，提升公司市场占有率。凭借较强的市场开拓能力，近年来公司已与海力士、长江存储、华虹集团、中芯国际及长电科技等国内外半导体行业龙头企业形成了较为稳定的合作关系，收入及利润规模也得以快速增长。

综上所述，公司创新的市场开拓策略及较强的市场开拓能力可为本项目提供可靠的产能消化保障。

（四）项目与现有主营业务的关联度分析

公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，主要产品包括半导体清洗设备、半导体电镀设备和先进封装湿法设备等。公司坚持差异化竞争和创新的发展战略，通过自主研发的单片兆声波清洗技术、单片槽式组合清洗技术、电镀技术、无应力抛光技术和立式炉管技术等，向全球晶圆制造、先进封装及其他客户提供定制化的设备及工艺解决方案，目前已发展成为中国大陆少数具有一定国际竞争力的半导体设备供应商，产品得到众多国内外主流半导体厂商的认可，并取得良好的市场口碑。

本项目将充分发挥公司现有产品系列、核心技术、客户资源等优势，进一步增强盛美韩国的研发及生产能力，加快推进全球化产业布局，是公司实现成为全球平台化半导体设备公司战略目标的重要步骤。

（五）主要风险分析

1. 海外投资风险

公司通过本项目在韩国建立厂区，开拓韩国及全球市场，提升公司在韩国及国际的影响力。韩国是全球主要的半导体设备市场之一，具有较为发达和完善的半导体产业链，但作为海外投资项目，潜在风险也不容忽视。公司在韩国建立厂区，海外投资规模加大，对公司的管理制度、资源整合等多方面提出了更高要求。如果公司管理层不能适应公司海外规模的较大扩张，那么公司将面临管理经营风险。此外，政策风险亦是海外投资的主要风险之一。因此，本项目的建设可能会面临管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。

针对上述风险，公司制定了一系列的应对措施：首先，公司将进一步完善管理体系，加强对韩国投资项目的管理和内部控制，不断适应业务要求和政策变化，积极防范和应对管理风险；其次，公司子公司盛美韩国将充分深入开展市场调研，以掌握当地国情和政策法规，审慎决策；再者，公司严格遵守相关法律法规、行业准则以及当地政策，坚持合规经营、安全生产，做好突发事件应急预案。

2. 市场风险

全球半导体设备行业市场竞争激烈，公司产品在其面向的市场与国际巨头直接竞争。国际巨头企业拥有更强的资金实力、技术储备、销售团队、制造能力、销售渠道和市场知名度，拥有更广泛的客户和合作伙伴关系，也拥有更长的经营历史、更为丰富的产品系列、更为广泛的地域覆盖，能够更好地识别和应对市场和客户需求的变化。本项目建成后，公司半导体设备的生产能力将大幅提升，最终能否顺利开拓市场并消化产能，将直接影响到项目投资的收益。尽管公司已对本项目进行了全面细致的可行性认证，对该项目的市场、技术、财务等影响进行了详细的预测分析，但如果后期市场情况发生不可预见的变化，或者公司不能有效开拓新市场，将存在产能消化风险。

针对上述风险，公司制定了一系列的应对措施：首先，公司将对市场形势和客户需求状况进行及时跟踪分析，建立系统明确的销售目标；根据目标方案分派具体的执行人员严格组织实施，严格控制销售风险；其次，公司将按照稳健的步伐完善营销服务，不断改进客户服务，增强公司产品服务能力；再者，公司将提升自身的研发能力，加快新产品、新技术的研发进程。

3. 产品研发风险

本建设项目的产品包括公司已量产产品及研发产品。量产产品需要适应市场需求变化，不断优化升级。研发产品为公司前期进行充分论证和研讨，综合考虑行业发展趋势、国际市场环境并结合公司自身发展需求进行规划的。半导体设备行业具有技术密集型的特点，研发技术能力是公司的核心竞争力。如果公司不能对技术趋势有精准的判断，在产品优化升级方面或新产品新技术的研发上不能满足行业标准或者下游厂商的要求，将面临因研发技术创新能力无法满足客户需求而导致的市场竞争力降低的风险。

公司将通过人才培训和人才招聘两方面，不断提高研发人员的专业水平来应对可能的技术研发风险。在人才培训方面，公司将建立内外部培训体系，一方面，通过在企业内部建立课程或讲师培训体系，不断提高员工的专业水平；另一方面，公司将为员工提供外部培训机会，为员工开阔行业视野，保持对行业前沿科技的高度敏感性，保持公司在行业内前沿的技术水平。在人才招聘方面，公司将通过人才市场、大型招聘网站、高校招聘会等公开渠道发布企业招聘需求，提升公司在韩国的招聘信息覆盖范围。同时公司将建立完善的薪酬体系和奖励制度，吸引优秀人才。

（六）保障超募资金安全的措施

本项目相关审批程序履行完成后，公司将开立募集资金专用账户，专项存储投入的超募资金，并与盛美韩国、保荐机构和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储四方监管协议，公司将根据新建项目的实施进度，逐步投入募集资金并对项目实施单独建账核算。公司董事会授权管理层及其授权人士全权办理与本次设立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。公司将严格按照《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定实施监管监督，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

五、相关审议程序

公司于2023年2月23日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资孙公司增资以实施新建项目的议案》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用部分超募资金向全资孙公司增资以实施新建项目的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》等的规定。本次事项已经通过董事会审议，议案内容及表决情况符合相关规定，履行了必要的程序。公司本次事项符合公司主营业务发展方向，符合公司募集资金使用计划，有利于公司长远发展、提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司本次超募资金的使用与募集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形。

综上，公司独立董事同意本次使用部分超募资金向全资孙公司增资以实施新建项目的相关事项。

（二）监事会意见

公司监事会认为：本次使用部分超募资金向全资孙公司增资以实施新建项目的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》等的规定，符合公司主营业务发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次超募资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。

综上，公司监事会同意使用部分超募资金向全资孙公司增资以实施新建项目的相关事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金向全资孙公司增资以实施新建项目事项已经第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司本次使用超募资金事项的相关审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司募集资金管理制度》的要求。

公司本次使用部分超募资金向全资孙公司增资以实施新建项目事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金向全资孙公司增资以实施新建项目事项无异议。

七、上网公告附件

（一）《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

（二）《海通证券股份有限公司关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司使用部分超募资金向全资孙公司增资以实施新建项目事项的核查意见》。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2023年2月25日

公司代码：688082　公司简称：盛美上海

盛美半导体设备(上海)股份有限公司2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析：四、风险因素"部分内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，公司2022年度利润分配预案如下：截至2022年12月31日，公司总股本共433,557,100股，拟每10股派发现金红利3.72元（含税），共计派发现金红利161,283,241.20元（含税），本次利润分配现金分红金额占2022年合并报表归属于母公司股东净利润的24.13%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

该利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	盛美上海	688082	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	罗明珠	/
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路1690号第4幢	/
电话	021-50276506	/
电子信箱	ir@acmrsh.com	/

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

1.主要业务

公司从事对先进集成电路制造与先进晶圆级封装制造行业至关重要的单晶圆及槽式湿法清洗设备、电镀设备、无应力抛光设备、立式炉管设备和前道涂胶显影设备和等离子体增强化学气相沉积设备等的开发、制造和销售，并致力于为半导体制造商提供定制化、高性能、低消耗的工艺解决方案，有效提升客户多个步骤的生产效率、产品良率，并降低生产成本。

2.主要产品

公司经过多年持续的研发投入和技术积累，先后开发了前道半导体工艺设备，包括清洗设备、半导体电镀设备、立式炉管系列设备（包括氧化、扩散、真空回火、LPCVD、ALD）、涂胶显影Track设备、等离子体增强化学气相沉积PECVD设备、无应力抛光设备；后道先进封装工艺设备以及硅材料衬底制造工艺设备等。

（1）前道半导体工艺设备

①清洗设备

A.SAPS兆声波单片清洗设备

晶圆表面的兆声波能量与晶圆和兆声波发生器之间的距离呈现周期性的变化。在传统的兆声波清洗工艺中，不同工序后应力带来的晶圆翘曲，使得晶圆上不同点到兆声波发生器的距离不同，因此晶圆上不同位置的兆声波能量也不相同，无法实现兆声波能量在晶圆表面的均匀分布。而且由于硬件位置控制的误差，也会造成兆声波能量在晶圆表面分布的不均匀。

公司自主研发的SAPS兆声波技术采用扇形兆声波发生器，通过精确匹配晶圆旋转速度、液膜厚度、兆声波发生器的位置、交变位移及能量等关键工艺参数，通过在工艺中控制兆声波发生器和晶圆之间的半波长范围的相对运动，使晶圆上每一点在工艺时间内接收到的兆声波能量都相同，从而很好的控制了兆声波能量在晶圆表面的均匀分布。

B.TEBO兆声波单片清洗设备

公司自主研发的TEBO清洗设备，可适用于28nm及以下的图形晶圆清洗，通过一系列快速（频率达到每秒一百万次）的压力变化，使得气泡在受控的温度下保持尺寸和形状振荡，将气泡控制在稳定震荡状态，而不会内爆，从而保持晶圆微结构不被破坏，对晶圆表面图形结构进行无损伤清洗。公司TEBO清洗设备，在器件结构从2D转换为3D的技术转移中，可应用于更为精细的具有3D结构的FinFET、DRAM和新兴3D NAND等产品，以及未来新型纳米器件和量子器件等，在提高客户产品良率方面发挥越来越重要的作用。

公司通过自主研发并具有全球知识产权保护的SAPS和TEBO兆声波清洗技术，解决了兆声波技术在集成电路单片清洗设备上应用时，兆声波能量如何在晶圆上均匀分布及如何实现图形结构无损伤的全球性难题。为实现产能最大化，公司单片清洗设备可根据客户需求配置多个工艺腔体，最高可单台配置18腔体，有效提升客户的生产效率。

C.高温单片SPM设备

随着技术节点推进到10nm及以下，工艺温度要求在145摄氏度以上，甚至超过200摄氏度的SPM工艺步骤逐渐增加。高剂量离子注入后的光刻胶去除、无灰化步骤的纯湿法去胶工艺，以及特殊的金属膜层刻蚀或剥离，都对SPM的温度提出了更高的要求。公司的新型单片高温SPM设备使用独特的多级喷嘴加热系统来预热硫酸，然后将硫酸与过氧化氢混合以达到超高温。同时，公司的腔体支持配置其他多种化学品，并配备在线化学品混酸（CIM）系统，可用于动态设置工艺中的化学品配比及温度。该腔体配置还可支持更多的化学品和灵活的辅助清洗方案，比如公司独有的专利技术SAPS和TEBO兆声波技术。该设备可支持300mm晶圆单片SPM（硫酸和过氧化氢混合酸）工艺，可广泛用于先进逻辑、DRAM、3D-NAND等集成电路制造中的湿法清洗和刻蚀工艺，尤其针对处理高剂量离子注入后的光刻胶（PR）去除工艺，以及金属刻蚀、剥离工艺。

D.单片槽式组合清洗设备

公司自主研发的具有全球知识产权保护的Tahoe清洗设备在单个湿法清洗设备中集成了两个模块：槽式模块和单片模块。Tahoe清洗设备可被应用于光刻胶去除，刻蚀后清洗，离子注入后清洗，机械抛光后清洗等几十道关键清洗工艺中。Tahoe清洗设备的清洗效果与工艺适用性可与单片中温SPM清洗设备相媲美，与此同时，与单片清洗设备相比，还可大幅减少硫酸使用量，帮助客户降低了生产成本又能更好的符合节能减排的政策。该设备已完成客户端验证，进入量产阶段。

E.单片背面清洗设备

公司研发的单片背面清洗设备采用伯努利卡盘，应用空气动力学悬浮原理，使用机械手将晶圆送入腔体后，使晶背朝上，晶圆正面朝下，在工艺过程中，精准流量控制的高纯氮气通过晶圆与卡具之间的空隙。该设备可用于背面金属污染清洗及背面刻蚀等核心工艺。

F.边缘湿法刻蚀设备

该设备支持多种器件和工艺，包括3D NAND、DRAM和先进逻辑工艺，使用湿法刻蚀方法来去除晶圆边缘的各种电介质、金属和有机材料薄膜，以及颗粒污染物。这种方法最大限度地减少了边缘污染对后续工艺步骤的影响，提高了芯片制造的良率，同时整合背面晶圆清洗的功能，进一步优化了工艺和产品结构。

G.前道刷洗设备

采用单片腔体对晶圆正背面依工序清洗，可进行包括晶圆背面刷洗、晶圆边缘刷洗、正背面二流体清洗等清洗工序；设备占地面积小，产能高，稳定性强，多种清洗方式灵活可选。可用于集成电路制造流程中前段至后段各道刷洗工艺。

H.全自动槽式清洗设备

公司开发的全自动槽式清洗设备广泛应用于集成电路领域和先进封装领域的清洗、刻蚀、光刻胶去除等工艺，采用纯水、碱性药液、酸性药液作为清洗剂，与喷淋、热浸、溢流和鼓泡等清洗方式组合，再配以先进的常压IPA干燥技术及先进的低压IPA干燥技术，能够同时清洗50片晶圆。该设备自动化程度高，设备稳定性好，清洗效率高，金属、材料及颗粒的交叉污染低。该设备主要应用于40nm及以上技术节点的几乎所有清洗工艺步骤。

②半导体电镀设备

A.前道铜互连电镀铜设备

公司自主开发针对28-14nm及以下技术节点的IC前道铜互连镀铜技术Ultra ECP map。公司的多阳极局部电镀技术采用新型的电流控制方法，实现不同阳极之间毫秒级别的快速切换，可在超薄籽晶层（5nm）上完成无空穴填充，同时通过对不同阳极的电流调整，在无空穴填充后实现更好的沉积铜膜厚的均匀性，可满足先进工艺的镀铜需求。

B.三维堆叠电镀设备

应用于填充3d硅通孔TSV和2.5d转接板的三维电镀设备Ultra ECP 3d。基于盛美半导体电镀设备的平台，该设备可为高深宽比（深宽比大于10:1）铜应用提供高性能、无孔洞的镀铜功能。为提高产能而做的堆叠式腔体设计，该设备还能减少消耗品的使用，降低成本，节省设备使用面积。

C.新型化合物半导体电镀设备

2022年Ultra?ECP?GIII电镀设备在客户实现量产，应用于背面深孔镀金和金互联线以及Cu-Ni-Au等领域。通过差异化的技术以及灵活的模块化设计，使新型化合物半导体电镀机的竞争力进一步提升。

③立式炉管系列设备

公司研发的立式炉管设备主要包括LPCVD、氧化炉、扩散炉和炉管ALD。报告期内，公司以Ultra Fn立式炉设备平台为基础，进一步推出了ALD（热原子层沉积）立式炉Ultra FnA。这款设备聚焦核心技术研发，力求满足高产能批式ALD工艺的高端要求。在能满足原子层沉积工艺的同时具备低累积膜厚气体清洗功能，保证颗粒的稳定性。

④前道涂胶显影Track设备

公司的前道涂胶显影Ultra LithTM Track设备是一款应用于300毫米前道集成电路制造工艺的设备，可提供均匀的下降气流、高速稳定的机械手以及强大的软件系统，从而满足客户的特定需求。该设备功能多样，能够降低产品缺陷率，提高产能，节约总体拥有成本（COO）。涂胶显影Track设备支持主流光刻机接口，支持包括i-line、KrF和ArF系统在内的各种光刻工艺，可确保满足工艺要求的同时，让晶圆在光刻设备中曝光前后的涂胶和显影步骤得到优化。

⑤等离子体增强化学气相沉积PECVD设备

公司的等离子体增强化学气相沉积Ultra PmaxTM PECVD设备配置自主知识产权的腔体、气体分配装置和卡盘设计，能够提供更好的薄膜均匀性，更优化的薄膜应力和更少的颗粒特性。

⑥无应力铜互连平坦化设备

公司的无应力抛光设备将无应力抛光技术SFP（Stress-Free-Polish）与低下压力化学机械平坦化技术CMP相结合，集成创新了低k/超低k介电质铜互连平坦化Ultra-SFP抛光集成系统，集合二者优点，利用低下压力化学机械抛光先将铜互联结构中铜膜抛至150nm厚度，再采用无应力抛光SFP智能抛光控制将直至阻挡层。再采用公司自主开发的热气相刻蚀技术，将阻挡层去除。无应力抛光设备应用于铜低k/超低k互连结构有诸多优点：其一，依靠抛光自动停止原理，平坦化工艺后凹陷更均匀及精确可控；其二，工艺简单，采用环保的可以循环实用的电化学抛光液，没有抛光垫，研磨液等，耗材成本降低50%以上；对互联结构中金属层和介质层无划伤及机械损伤；其三，可以将工艺扩展至新型材料钴（Co）和钌（Ru）作为阻挡层的铜低k/超低k互联结构中。

⑦新型化合物半导体刻蚀设备

公司推出了6/8寸化合物半导体湿法工艺产品线，以支持化合物半导体领域的工艺应用，包括碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)和砷化镓(GaAs)等。

（2）后道先进封装工艺设备

①先进封装电镀设备

公司在半导体先进封装领域进行差异化开发，解决了在更大电镀液流量下实现平稳电镀的难题，2022年在高速电镀锡银方面也实现突破，在客户端成功量产。采用独创的第二阳极电场控制技术更好地控制晶圆平边或缺口区域的膜厚均匀性控制，实现高电流密度条件下的电镀，凸块产品的各项指标均满足客户要求。在针对高密度封装的电镀领域可以实现2μm超细RDL线的电镀以及包括铜、镍、锡、银和金在内的各种金属层电镀。自主开发的橡胶环密封专利技术可以实现更好的密封效果。2022年进一步扩大市场规模并取得高端客户的批量订单。

②涂胶设备

公司的升级版8/12寸兼容的涂胶设备，用于晶圆级封装领域的光刻胶和Polyimide涂布、软烤及边缘去除。涂胶腔内采用了公司特有的全方位无死角自动清洗技术，可缩短设备维护时间。这款升级版涂胶设备对盛美原有的涂胶设备性能和外观都进行了优化升级，可实现热板抽屉式抽出，方便维修及更换，并且能精确复位，有效保障工序运行。

③显影设备

公司的Ultra C dv显影设备可应用于晶圆级封装，是WLP光刻工艺中的步骤。设备可进行曝光后烘烤、显影和坚膜等关键步骤。设备具备灵活的喷嘴扫描系统，能够实现精准的药液控制，技术先进，使用便捷。

④湿法刻蚀设备

公司的湿法刻蚀设备使用化学药液进行晶圆球下金属层（UBM）的刻蚀工艺。该设备具备先进的喷嘴扫描系统，可提供行业领先的化学温度控制、刻蚀均匀性，专注安全性，且药液回收使用可减少成本。

⑤湿法去胶设备

公司的Ultra C pr湿法去胶设备设计高效、控制精确，提升了安全性，提高了WLP产能。该设备将湿法槽式浸洗与单片晶圆清洗相结合，能够在灵活控制清洗的同时，最大限度地提高效率，也可与公司专有的SAPS兆声波清洗设备一同使用，以清除极厚或者极难去除的光刻胶涂层。

⑥金属剥离设备

公司的湿法金属剥离（Metal Lift off）设备基于公司已有的湿法去胶设备平台，将槽式去胶浸泡模块与单片清洗腔体串联起来依序使用，在去胶的同时进行金属剥离。该设备可以在不同单片清洗腔中分别配置去胶功能和清洗功能，并通过优化腔体结构，实现易拆卸、清洗与维护，以解决金属剥离工艺中残留物累积的问题。（下转C50版）